

2026 年 8 月 7 日

各 位

高周波基板用電解銅箔「VSP™」の生産能力増強

～ 2030 年に向けて総額 70 億円の投資を行い、月産 1,400t 体制で生産能力 2 倍へ ～

当社（社長 池信省爾）は、現在台湾工場（台湾銅箔股份有限公司）およびマレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia) Sdn. Bhd.）にて製造している高周波基板用銅箔「VSP™」の生産体制について、両工場での生産能力追加増強により、[2025 年 11 月 11 日付ニュースリリース「高周波基板用電解銅箔「VSP™」の生産体制増強」](#)にて公表しました 2028 年度までの月産 1,200t への増強に加え、さらに総額 70 億円を投じ、200t 増の月産 1,400t 体制とする計画を決定したことをお知らせいたします。

当社の高周波基板用電解銅箔「VSP™」は、高周波数帯におけるプリント基板の伝送損失低減に大きく寄与することから、サーバー、ルーター、スイッチ等の高性能通信インフラ機器に採用されております。足元は AI インフラ関連向けに HVLP5 グレード品が量産フェーズに移行し、ビッグテック各社での採用が進むなど市場での当社 VSP™ の需要が急激に増加しており、今後も更なる拡大が期待されます。

これらの施策により生産能力は増加いたしますが、今後もさらなる需要拡大に応じた増強も視野に入れ、旺盛な需要に十分対応してまいります。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030 年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で “未来” に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献してまいります。

■VSP™生産能力（ご参考）

単位：t/月	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2030 年度
台湾工場	600	720	760	860	960
マレーシア工場	120	120	240	340	440
計	720	840	1,000	1,200	1,400

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028 E-mail : PR@mitsui-kinzoku.com



汎用銅箔



VSP™

写真 アップルマンゴーが映り込んだ銅箔の表面

※VSP™は、鏡面のような優れた表面平滑性が特徴



台湾工場

(台湾銅箔股份有限公司)



マレーシア工場

(Mitsui Copper Foil (Malaysia) Sdn Bhd)

写真 増産する台湾工場とマレーシア工場

(ご参考)

VSP™の主な用途：

通信インフラ機器（サーバー、スイッチ、ルーター、基地局など）などの高周波基板用銅箔